



***Ready for 5G**

PRODUCT DESCRIPTION

Tpli™ 200 is a premium gap filler. A unique blend of boron nitride and silicone produce the highest performing interface pad.

Tpli 200's exceptional combination of high thermal conductivity and compliancy generate unmatched thermal resistances in a gap filling interface material.

Tpli 200 absorbs shock and relieves stresses, thus minimizing potential damage to components. Tpli 200 is electrically insulating, stable from -45°C to 200°C, and meets UL 94 HB rating.

FEATURES AND BENEFITS

- Soft and compliant
- High Thermal performance
- Environmentally friendly solution that meets regulatory requirements including RoHS and REACH

SPECIFICATIONS

TYPICAL PROPERTIES	TYPICAL VALUE	TEST METHOD
Construction & Composition	Boron nitride filled silicone sheet	N/A
Color	Varies by thickness	Visual
Thickness Range	0.25mm (0.010") - 5.08mm (0.20")	N/A
Thickness Tolerance	+/- 10%	N/A
Thermal Conductivity (W/mK)	6.0	ASTM D5470
Density (g/cc)	1.4	Helium Pyncometer
Hardness (Shore 00)	70	ASTM D2240
Outgassing TML (weight %)	0.51	ASTM E595
Outgassing CVCN (weight %)	0.17	ASTM E595
Temperature Range	-45°C to 200°C	N/A
Rth@ 40 mils, 10 psi, 50°C	0.25°C-in ² /W	ASTM D5470 (modified)
* Dielectric Constant @ 10GHz	3.2 *	ASTM D150
UL Flammability Rating	HB	UL 94
Volume Resistivity	5x10 ¹³ ohm-cm	ASTM D257



Tpli 200 Series Thermal Gap Filler

AVAILABILITY

STANDARD THICKNESSES

- 0.25mm (0.010") to 5.0mm (0.200") thick material available in 0.25mm (0.010") increments
- Available in standard sheet sizes of 18" x 18" and 9" x 9" or custom die cut parts

REINFORCEMENT

- Fiberglass is required in thicknesses of 0.010" (0.25mm) and 0.015" (0.38mm)
- Reinforcement is optional in thicknesses 0.020" (0.5mm) and 0.025" (0.63mm). Indicate fiberglass by "FG" suffix
- Thicknesses above 0.025" (0.063mm) are not reinforced

OPTIONS

- A0 - no adhesive
- A1 – adhesive on one side

POST CURE

- Post Curing option available. Indicate fiberglass by "PC" suffix

PART NUMBER SYSTEM

Tflex™ indicates Laird elastomeric thermal gap filler product line. Tpli 2xx indicates Tpli 200 product line with thickness in mils (0.001")

EXAMPLES:

- Tpli 240,A0 = 0.040 inch thick Tpli™ 200 material with no adhesive
- Tpli 280,A1 = 0.080 inch thick Tpli™ 200 material with one side adhesive
- Tpli 220FG,A1 = 0.020 inch thick Tpli™ 200 material with fiberglass reinforcement and one side adhesive
- Tpli 260,PC = 0.060 inch thick Tpli™ 200 material post cured

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9